

### Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ	
1	Cu+galv.Cu	0.51	18+25		
	Tr-Lam				
	No-Flow-PP			0.063	106
	No-Flow-PP			0.063	106
2	Abdeckfolie	0.075		PI+Kleber	
	Cu	0.065	35	PI+Kleber	
	Flex-Lam				
3	Cu		35	PI+Kleber	
4	Abdeckfolie	0.075		PI+Kleber	
	No-Flow-PP	0.063	18+25	106	
	No-Flow-PP			106	
	Tr-Lam				
Cu+galv.Cu					

Presslingsdicke*	1,44	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske*	1,55	+/- 10%

### Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

### Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm